

■ 許容損失について (DFN1414-6)

DFN1414-6 パッケージの許容損失について特性例を示します。(DFN1212-6 パッケージのデータを代用)
 なお、許容損失は実装条件に左右されますので、本特性例は下記測定条件での参考データとなります。

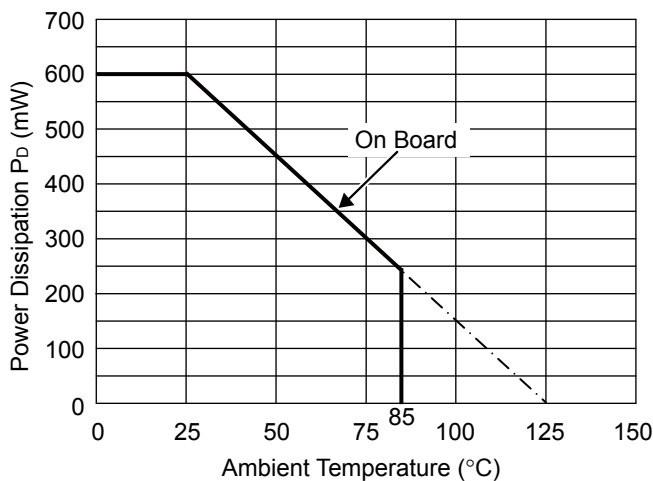
測定条件

標準実装条件	
測定状態	基板実装状態 (風速 0m/s)
基板材質	ガラスエポキシ樹脂 (両面基板)
基板サイズ	40mm × 40mm × 1.6mm
配線率	表面 約50%、裏面 約50%
スルーホール	直径 0.5mm × 28個

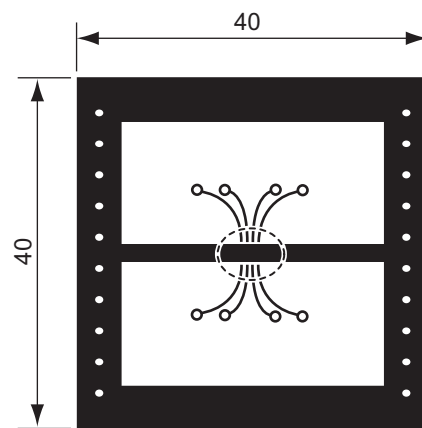
測定結果

(Ta=25°C, Tjmax=125°C)

標準実装条件	
許容損失	600mW
熱抵抗値	$\theta_{ja} = (125 - 25^\circ\text{C}) / 0.6\text{W} = 167^\circ\text{C/W}$
	$\theta_{jc} = 30^\circ\text{C/W}$



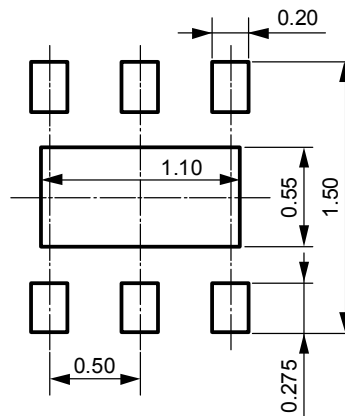
許容損失特性



測定用基板レイアウト

○ IC 実装位置 (単位: mm)

■ 基板パッド推奨寸法 (DFN1414-6)



(単位: mm)